

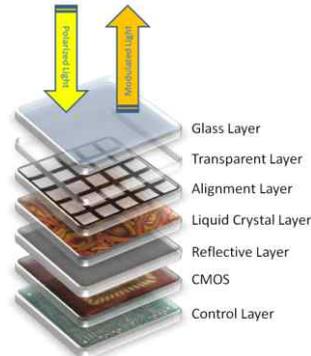
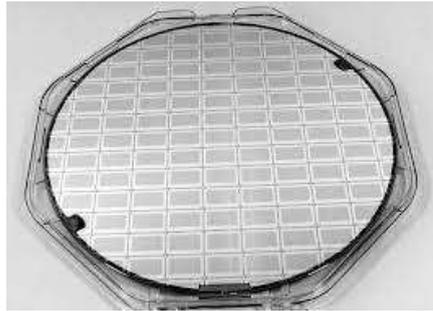
상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	LCoS Main Chip Wafer (RDP370FACZ)	장	8	-

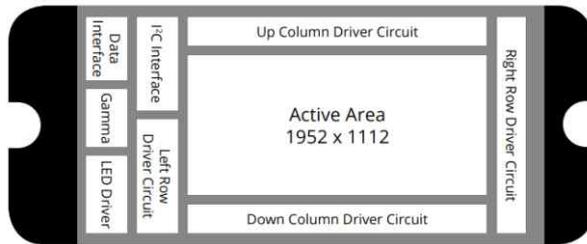
상 세 내 역

1. 주요규격

① LCoS Main Chip Wafer (RDP370FACZ)



< LCoS Main-chip wafer 및 LCoS 마이크로 디스플레이 소자 구조 예시 이미지 >



< LCoS Main Chip 기능 예시 이미지 >

- wafer size : 8 inches
- Active area size: 0.37"
- (1952x1112) array of 4.3 μ m mirrors
- High reflectivity: over 82%
- Contrast ratio: 500:1 (at FSC driving)
- Active area: 8.393 x 4.781 mm
- Module size: 23.4 x 8.65 mm
- Power consumption: 120 mW
- Fast VA (Vertical Alignment) LC mode

2. 기타사항

- 가. 납품위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 XR 디바이스 개발 지원센터 202호
- 나. 납품개요 : 규격서의 조건에 맞는 물품을 납품
- 다. 납품기한 : 계약일로부터 14일 이내
- 라. 규격문의 : 실감미디어연구센터 김재윤 선임연구원(054-460-9057)